



HoLR2512D封体合金系列规格书

系列号	HoLR
修订日期	2022-08-16
版本号	Ho-A0



GdYWZqWUjcb

K

Á

P[ŠÜG FGÖÁ

P[ŠÜG FGÖ

Á

■ Features:

- 合金芯片，封体工艺，焊接性能良好
- 高可靠性，高过载能力，产品精度高。使用温度范围较宽无感型设计
- 电阻温度系数 $TCR \times 10^{-6}/^{\circ}C$
- $\leq 25-50ppm$ 符合 ROHS 要求和无卤要求
- 全系列产品符合车规AEC-Q200测试。

■ 产品名称 Product Name

封体合金电阻

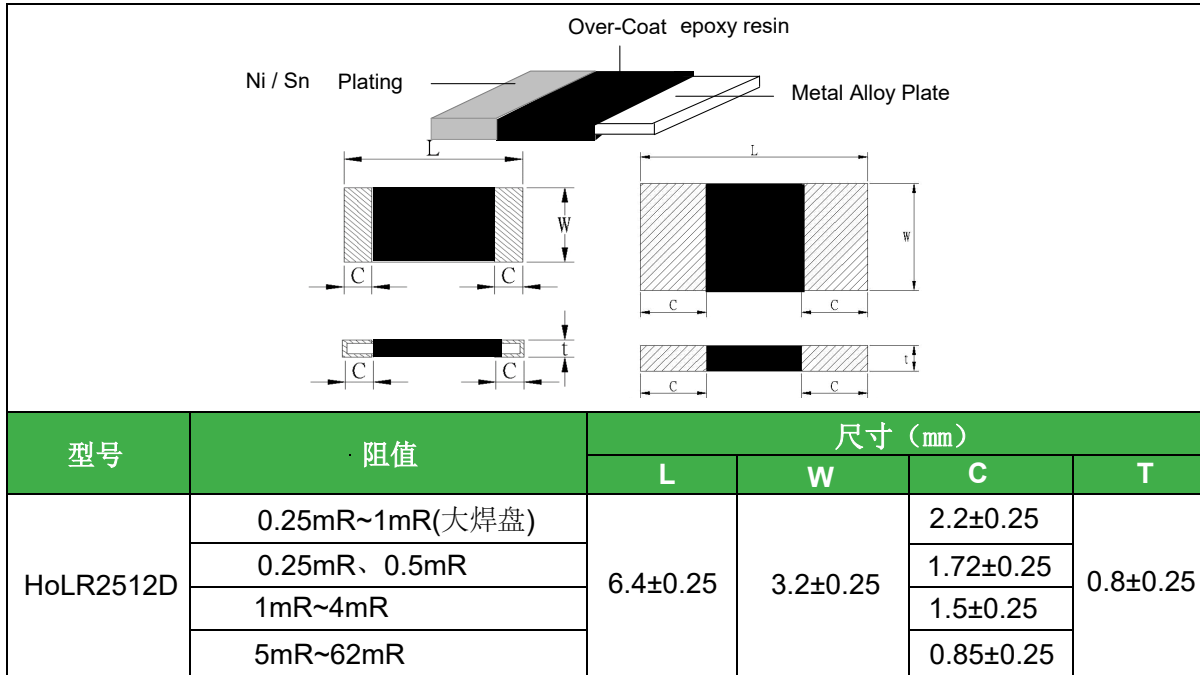
■ 产品型号 Product number

Ho	LR	2512D	3mR	1%
↓	↓	↓	↓	↓
制造商	产品系列	封装	阻值	精度
Ho 毫欧电子	LR 合金	2512D	0.25~62mR	±0.5% ±1% ±5%



系列号	HoLR
修订日期	2022-08-16
版本号	Ho-A0

■ 产品结构及尺寸 Product structure and size

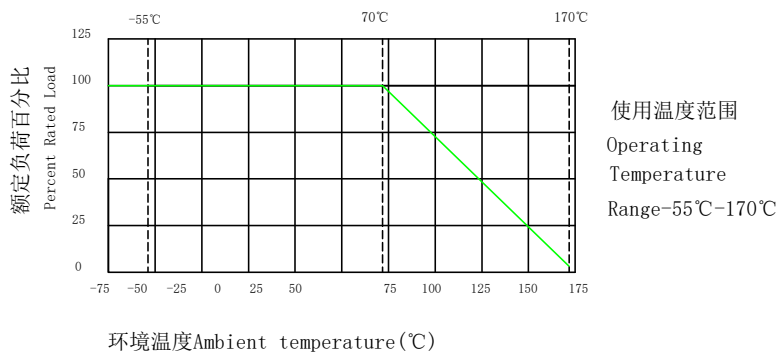


■ 电气参数 Electrical parameter

额定功率 Rated power	3W、3.5W
阻值范围 Resistance range	0.25mR~62mR (3W) , 0.25mR~1mR(3.5W大焊盘)
最大额定电流 Max.Rated Current	109.54A, 118.32A
准确度等级 AccuracyClass	0.5%、1%、5%
20℃~60℃电阻温度系数 T.C.R (ppm / °C)	≤25-50
工作温度范围 Operating Temperature Range	-55℃~+170℃

■ 功率曲线 Power curve

操作温度范围 -55 ~+170 °C 电阻温度达到 70°C时降功率示意图



地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

系列号	HoLR
修订日期	2022-08-16
版本号	Ho-A0

■ 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu

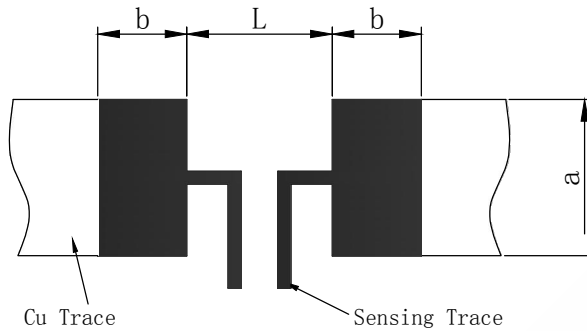
I :Rated Current (A)

P:Rated Power (W)

R:Resistance Value (Ω)

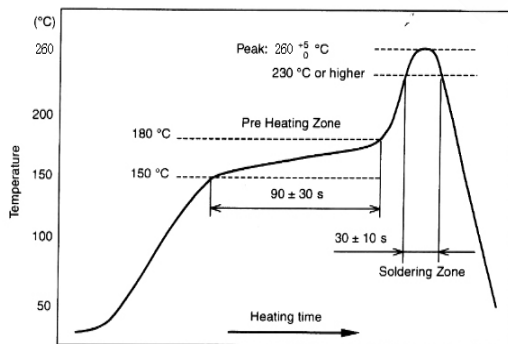
$$I = \sqrt{P/R}$$

■ 建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension

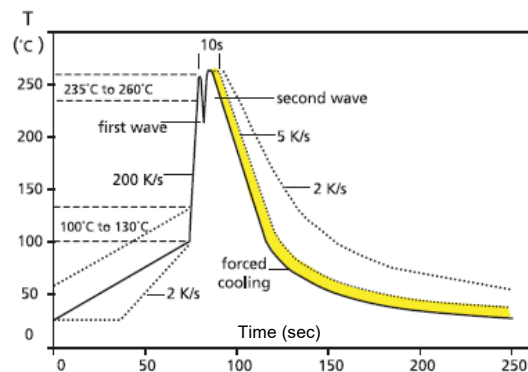


型号	阻值	尺寸 (mm)		
		a	b	L
2512D	0.25~1	4.0	3.15	1.15
	0.25~0.5		2.57	2.11
	1~4		2.35	2.55
	5~62		1.70	3.85

■ 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters



回流焊曲线图

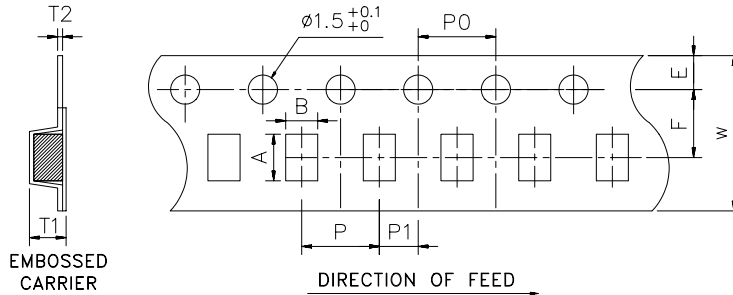


波峰焊曲线图

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

系列号	HoLR
修订日期	2022-08-16
版本号	Ho-A0

■ 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)



A	B	W	F	E	T1	T2	P	P0	P1
6.9±0.2	3.6±0.2	12±0.2	5.5±0.1	1.75±0.1	1.08±0.1	0.24±0.1	4±0.1	4±0.1	2.0±0.10

■ 可靠性测试 Reliability Tests

Test Items	Reference standard	Condition of Test	Test Limits
Temperature Coefficient of Resistance	IEC60115-1 4.8 JIS C 5201-1 4.8	+25°C ~ +125°C	Refer 4.0
Load Life	IEC60115-1 4.25.1 JIS C 5201-1 4.25.1	1000hours at rated power, 70°C, 1.5hours "ON", 0.5hour "OFF"	< ±1%
Short Time Overload	IEC60115-1 4.13 JIS C 5201-1 4.13	2 X rated power for 5s	< ±0.5%
Moisture no Load	IEC60115-1 4.24.2.1a) JIS C 5201-1 4.24.2.1a)	85°C, 85%RH, 1000hrs	< ±1%
Temperature cycle	IEC60115-1 4.19 JIS C 5201-1 4.19	-55°C & +155°C, 300cycle, 15min per extreme condition	< ±0.5%
Resistance to Soldering Heat	IEC60115-1 4.18 JIS C 5201-1 4.18	260±5°C for 20±1 sec	< ±0.5%
Solderability	IEC60115-1 4.17 JIS C 5201-1 4.17	245±5°C, 2±0.5sec	At least 95% of surface area of electrode shall be covered with new solder
High Temperature Exposure	IEC60115-1 4.23.2 JIS C 5201-1 4.23.2	170°C, 1000hrs	< ±1%
Low Temperature Storage	IEC60115-1 4.23.4 JIS C 5201-1 4.23.4	-55°C, 1000hrs	< ±0.5%
Substrate Bending	IEC60115-1 4.33 JIS C 5201-1 4.33	Bending width 2mm	< ±1%
Insulation Resistance	IEC60115-1 4.6 JIS C 5201-1 4.6	100V DC for 1 minute	>100 MΩ

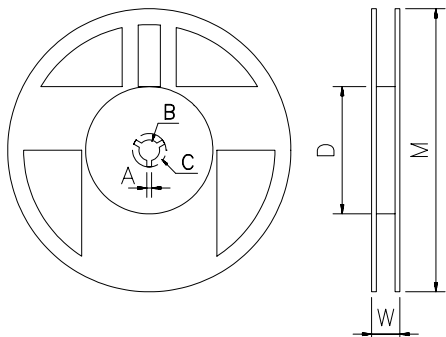
地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



HoLR2512D 封体合金系列规格书

系列号	HoLR
修订日期	2022-08-16
版本号	Ho-A3

■ 卷轴规格 Reel Specification



A	B	C	W	D	M
2.5±1	13.5±1	17.7±1	16.2±0.5	60±2	178±1

■ 包装方式 Packing

编带盘装：4000PCS/盘



地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼